

国立研究開発法人防災科学技術研究所 殿

(機関名)

(部署・職名)

(氏名)

《契約調印者、または知的財産権について出願・譲渡等の権限を持つ者》

## 知的財産権実施通知書

委託研究の成果に係る知的財産権の実施について、以下のとおり通知します。

## 1. 本通知に係る委託研究の概要

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 事業名                            | 戦略的イノベーション創造プログラム (S I P)<br>「国家レジリエンス (防災・減災) の強化」 |
| 研究開発課題名                        | 〇〇軽減のための〇〇機能の強化                                     |
| 研究題目                           | 〇〇に関する研究  |
| 契約番号                           | 21-〇-〇〇   |
| 研究 (開発) 担当者及び所属・職名<br>(研究実施当時) | 〇〇研究所 所長 〇〇 〇〇                                      |
| 研究 (開発) 期間                     | 20 年 月 日 ~ 20 年 月 日                                 |

※ 研究開発課題名等は委託研究契約書に記載の名称をご記入ください。

※ 「契約番号」は、直近のものを記入。

## 2. 対象となる知的財産権について

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 知的財産権の種類 (注1)         | 特許権           |
| 発明等の名称 (注2)           | 〇〇の計測方法       |
| 設定登録番号又は出願番号等<br>(注3) | 特願2021-001234 |

## 3. 実施等について

|      |  |
|------|--|
| 実施   | <input checked="" type="radio"/> 自己* (通常実施権・専用実施権等) (注4) |
| 特記事項 |  |

※第三者は実施許諾した場合

## (注意事項)

(注1) 種類については、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権又は著作権のうち、該当するものを記載して下さい。

(注2) 該当する①~④の事項を記入して下さい。

① 発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の名称

- ② 回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類（構造、技術、機能）
  - ③ 植物体の品種にあつては、農林水産植物の種類（属、種、亜種）、出願品種の名称
  - ④ 著作権にあつては、著作物の名称
- (注3) 番号については、当該種類に係る設定登録番号、設定登録の出願又は申請番号もしくは著作物の登録番号又は管理番号を記載して下さい。
- (注4) 自己又は第三者のいずれかを○で囲んでください。